

< 参加者募集 >

日米半導体プログラム UPWARDS に基づく
東北大学 サマープログラム 2026 夏期滞在

夏休みに東北大学に約12日間滞在し、自身の研究内容を議論しながら半導体について学ぶプログラムを実施します。参加を希望する方は、応募フォームから応募してください。滞在中の学費と経費は九大の旅費規程に則り、UPWARDSの寄附金で賄われる予定です。

Micron 財団および東京エレクトロンご支援の下、半導体人材育成を目的とした日米 UPWARDS (※) のプログラムを行っています。このプログラムには、日本の5大学（東北大、東京科学大、名古屋大、広島大、九州大）と米国6大学（University of Washington、Purdue University、Rochester Institute Technology、Rensselaer Polytechnic Institute、Virginia Tech、Boise State University）が参画しています。

記

- ・日程：2026年7月28日（火）～8月8日（土）
- ・場所：東北大学（宮城県仙台市）
- ・内容：学内の多様な研究室を訪問し、半導体研究の伝統と最先端技術の両方を体感するプログラム。
- ・対象者：半導体関連分野の学部または大学院に在籍する学生。
応募者が多い場合は志望動機・面接等で選抜。
女子の参加を強く推奨します。
- ・人数：1～3名
- ・滞在：東北大学提供の宿泊施設（ビジネスホテル予定）
- ・参加費：プログラムに含まれない現地食事代・課外活動費用については、参加者負担とする。
なお、移動のための交通費及び宿泊費用は大学負担とする（一部立替が必要）。
- ・募集期限：2026年2月25日(水) **2026年3月9日(月)**
- ・応募URL：<https://forms.gle/AJE4YLXEWd2VAe2t8>



- ・問合先：システム情報科学研究所 湯浅 (hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp)
UPWARDS 事務局 (upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp)